



# BUNDESPATENTGERICHT

Verkündet am  
26. Oktober 2016

20 W (pat) 28/14

...

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2005 039 764.6**

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. Oktober 2016 durch den Richter Dipl.-Ing. Musiol als Vorsitzenden, die Richterin Dorn sowie die Richter Dipl.-Ing. Albertshofer und Dipl.-Geophys. Dr. Wollny

beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. März 2014 wird aufgehoben und die Sache zur weiteren Behandlung – auf der Grundlage des im heutigen Termin gestellten Antrags – an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Patentanmeldung 10 2005 039 764.6 mit der Bezeichnung

„Vorrichtung für eine thermische Kopplung und Verfahren zur Herstellung einer thermischen Kopplung“

ist im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) von der Prüfungsstelle für Klasse G 01 K durch Beschluss vom 31. März 2014 zurückgewiesen worden. Zur Begründung hat die Prüfungsstelle insbesondere ausgeführt, dass der Durchschnittsfachmann durch eine Zusammenschau des in den Druckschriften D1 und D2 Beschriebenen zu einer Vorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelange. Für diese Zusammenschau bedürfe es keiner erfindерischen Leistung, weil beide Druckschriften dasselbe technische Gebiet beträfen. Der Anspruch 1 der Anmeldung sei daher wegen fehlender Erfindungshöhe seines Gegenstandes nicht gewährbar. Der nebengeordnete Verfahrensanspruch 10 entspräche in seinen technischen Merkmalen dem Vorrichtungsanspruch 1, Anspruch 10 sei daher ebenfalls wegen fehlender Erfindungshöhe seines Gegenstandes nicht gewährbar. Der Zurückweisungsbeschluss wurde der Anmelderin am 5. April 2014 zugestellt.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer am 25. April 2014 eingelegten Beschwerde.

Im Rahmen des Prüfungsverfahrens wurden seitens der Prüfungsstelle fünf Druckschriften genannt:

- D1 DE 31 26 931 A1,
- D2 CH 678 891 A5,
- D3 DE 199 13 195 A1,
- D4 DE 196 30 794 A1 und
- D5 US 2003/00 864 77 A1.

Der Senat hat mit Schreiben vom 25. Oktober 2016 noch folgende Druckschrift zum Stand der Technik ins Verfahren eingeführt:

- D6 DE 26 14 917 A1.

Die Bevollmächtigten der Anmelderin und Beschwerdeführerin haben die Anmeldung in der mündlichen Verhandlung vom 26. Oktober 2016 zuletzt mit einem einzigen, im Termin übergebenen neuen Anspruch verteidigt.

Sie beantragen,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. März 2014 aufzuheben und das nachgesuchte Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentanspruch 1, dem BPatG in der mündlichen Verhandlung am 26. Oktober 2016 überreicht,

anzupassende Beschreibung und Zeichnungen.

Der geltende einzige Anspruch lautet:

„Verfahren zur Herstellung einer thermischen Kopplung eines Temperatursensors (12) an ein Element (20), dessen Temperatur zu bestimmen ist, wobei zwischen dem Temperatursensor (12) und dem Element (20) ein wärmeleitendes Medium angeordnet wird, **dadurch gekennzeichnet**, dass in dem Element (20) eine Ausnehmung (26) ausgebildet wird, die Ausnehmung (26) zumindest teilweise mit einer flexiblen, kompressiblen Folie (28) als Medium überdeckt wird und der Temperatursensor (12) in die Ausnehmung (26) unter Mitnahme der Folie (28) zur thermischen Kopplung U-förmig hineingedrückt wird, wobei die Folie (28) als festes, elastisches Wärmeleitelement mit überwiegender flächiger Ausdehnung ausgebildet ist, wobei der Temperatursensor (12) auf einer Leiterplatte (14) angeordnet ist und wobei die Folie (26) mindestens zu zwei Seiten der Wandung (38) kontaktiert wird.“

Die Bevollmächtigten der Anmelderin und Beschwerdeführerin sind der Meinung, dass das Verfahren zur Herstellung einer thermischen Kopplung eines Temperatursensors nach dem nunmehr geltenden Anspruch neu sei und auf einer erfindерischen Tätigkeit beruhe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Zurückverweisung der Sache an das DPMA führt (§ 79 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und Nr. 3 PatG).

1. Die Patentanmeldung betrifft laut Seite 1, Absatz 1 der Ursprungsunterlagen eine Vorrichtung für eine thermische Kopplung eines Temperatursensors an ein Element, dessen Temperatur zu bestimmen ist, sowie ein entsprechendes Verfahren zur Herstellung einer thermischen Kopplung eines Temperatursensors an ein Element, dessen Temperatur zu bestimmen ist.

Es sei bekannt, die hohe thermische Verlustleistung von Transistoren über Kühlkörper an die Umgebung abzuführen. Um die Transistoren vor thermischer Überlast zu schützen, würden Transistoren mit integriertem thermischen Schutz eingesetzt oder der Temperaturschutz über einen externen Temperatursensor realisiert, der mittels Wärmeleitpaste oder Vergussmasse thermisch an den Kühlkörper und damit an den Transistor angekoppelt sei. Wenn die Temperatur einen vorgegebenen Grenzwert überschreite, werde die Leistung der Transistoren entsprechend reduziert. Dieses werde auch bei linearen Klimagebläsereglern angewendet. Nachteilig sei, dass Trocknungszeiten und spezielle Maßnahmen für die Trocknung der Wärmeleitpaste oder der Vergussmasse zu beachten seien. Würden Transistoren mit integriertem thermischen Schutz verwendet, müssten die mit diesen Transistoren verbundenen Nachteile und höhere Teilekosten in Kauf genommen werden (Ursprungsunterlagen, S. 1, Absatz 2 – S. 2, Absatz 1).

Erfindungsgemäß sei der Temperatursensor in einer Ausnehmung des Elements angeordnet, dessen Temperatur zu bestimmen sei, und ein wärmeleitendes Medium als flexible Folie ausgeführt, die mit dem Temperatursensor und mit einer Wandung der Ausnehmung zumindest teilweise in Kontakt stehe. Das Element besitze einen geringen Wärmewiderstand, erhitze sich mit dem wärmeerzeugenden Bauteil bzw. kühle sich mit diesem ab. Da das Medium eine flexible Folie sei, werde die thermische Anbindung des Temperatursensors fertigungsgünstig realisiert, da keine Trocknungszeiten mehr zu beachten seien und die Folie zwischen der Wandung des Elements und dem Temperatursensor liege. Der Begriff der Folie sei dahingehend zu verstehen, dass es sich um ein festes Wärmeleitelement handele, welches eine überwiegend flächige Ausdehnung und elastische Eigenschaften aufweise. Es sei nicht erforderlich, dass die Folie eine vernachlässigbare

Dicke besitze. Unter dem Begriff des Temperatursensors solle allgemein ein Bauteil verstanden werden, welches unter Zuhilfenahme von Messmitteln geeignet sei, eine Temperatur und/oder eine Temperaturänderung zu erfassen (Ursprungsunterlagen, S. 2, Absatz 2 – S. 3, Absatz 1).

Der einzige geltende Patentanspruch beschreibt ein Verfahren zur Herstellung einer thermischen Kopplung eines Temperatursensors und kann wie folgt gegliedert werden (Abweichungen zum Anspruch 10 gemäß Ursprungsunterlagen fett hervorgehoben):

- 1.0 Verfahren zur Herstellung einer thermischen Kopplung eines Temperatursensors (12) an ein Element (20), dessen Temperatur zu bestimmen ist,
  - 1.1 wobei zwischen dem Temperatursensor (12) und dem Element (20) ein wärmeleitendes Medium angeordnet wird,  
dadurch gekennzeichnet, dass
  - 1.2 in dem Element (20) eine Ausnehmung (26) ausgebildet wird, die Ausnehmung (26) zumindest teilweise mit einer flexiblen, **kompressiblen** Folie (28) als Medium überdeckt wird
  - 1.3 und der Temperatursensor (12) in die Ausnehmung (26) unter Mitnahme der Folie (28) **zur thermischen Kopplung U-förmig** hineingedrückt wird,
  - 1.4 **wobei die Folie (28) als festes, elastisches Wärmeleitelement mit überwiegender flächiger Ausdehnung ausgebildet ist,**
  - 1.5 **wobei der Temperatursensor (12) auf einer Leiterplatte (14) angeordnet ist und**
  - 1.6 **wobei die Folie (28) mindestens zu zwei Seiten der Wandung (38) kontaktiert wird.**
2. Als für die Beurteilung der Lehre der Anmeldung zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Diplom-Ingenieur der physikalischen Messtechnik an, der mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Temperaturmessung besitzt.

3. Der Inhalt des in der mündlichen Verhandlung verteidigten einzigen Anspruchs geht in zulässiger Weise auf die am 23. August 2005 ursprünglich beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten Anmeldeunterlagen zurück.

Das nun beanspruchte Verfahren zur Herstellung einer thermischen Kopplung eines Temperatursensors wird durch Merkmale beschrieben, die auf einer Zusammenfassung der ursprünglichen Ansprüche 10, 2, 3 und 6 beruhen bzw. auf Seite 2, letzter Absatz, bis Seite 3, zweiter Absatz, der Ursprungsunterlagen offenbart sind.

4. Mehrere Begrifflichkeiten im Anspruch bedürfen der näheren Erläuterung. Der oben definierte Fachmann legt denselben zur Überzeugung des Senates im Einzelnen folgendes Verständnis zugrunde:

Die Anmeldung zielt ganz allgemein darauf ab, einen Temperatursensor – der von seiner Arbeitsweise her nicht weiter spezifiziert wird – mittels eines Eindrückvorgangs an einem wie auch immer gearteten Bauteil (Element) zu befestigen. Insbesondere wird darauf Wert gelegt, dass nicht allein der Temperatursensor in eine für ihn vorgesehene Ausnehmung des genannten Elements gedrückt wird, sondern zusammen mit diesem ein als Folie bezeichnetes, nicht zwingend dünnes, aber wärmeleitendes, flächiges, festes und elastisches sowie kompressibles Medium, das den Kontakt mit der Ausnehmung verbessern und aufgrund seiner guten Wärmeleitungseigenschaften über eine gute thermische Kopplung positiv auf die Temperaturmessung wirken soll. Die Herstellung und Aufrechterhaltung guter thermischer Kontaktverhältnisse zwischen dem Temperatursensor und dem Element, an dem die Messung stattfindet, ist - unabhängig von indirekter oder direkter Temperaturbestimmung - funktionsnotwendig, da die Ansprechgeschwindigkeit des Sensors und seine Messgenauigkeit in Bezug auf die Temperatur des Elements bei schlechten Kontaktverhältnissen in der Regel stark von der Realität abweicht.

Die oben genannte Ausnehmung stellt in dieser allgemeinen Form ein nicht weiter spezifiziertes Volumen dar, das in Abweichung zur sonstigen äußeren Oberfläche des Elements eine Vertiefung in selbigem darstellt, lässt jedoch offen, ob hiermit lediglich eine Einbuchtung/-dellung oder auch eine vollständige Durchteufung seiner Oberfläche verbunden ist; daher ist mit dieser Begrifflichkeit hier prinzipiell beides umfasst.

5. Der Anmeldegegenstand ist ausführbar offenbart (§ 34 Abs. 4 PatG), da die in den Anmeldeunterlagen enthaltenden Angaben (vgl. insbesondere die Figuren 3 und 4 mit zugehöriger Beschreibung) dem fachmännischen Leser so viel an technischen Informationen vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen in der Lage ist, das anspruchsgemäße Verfahren erfolgreich auszuführen.

6. Der Gegenstand des einzigen Patentanspruchs gilt gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik als neu (§ 3 PatG).

Keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften zeigt ein Verfahren zur Herstellung einer thermischen Kopplung eines Temperatursensors, das alle Merkmale des einzigen Anspruchs aufweist. Sie zeigen insbesondere keinen Verfahrensschritt, bei dem eine Folie zunächst eine Ausnehmung zumindest teilweise überdeckt und in Folge gemeinsam mit dem Temperatursensor in die hierfür vorgesehene Ausnehmung gedrückt wird.

Aus der dem Sachgehalt des einzigen Patentanspruchs bisher als nächstkommander Stand der Technik ermittelten Druckschrift **D2** (CH 678 891 A5) ist ein Verfahren zur Herstellung einer thermischen Kopplung eines Temperatursensors („Temperaturfühler 1“) an ein Element („Rohrleitung 3“), dessen Temperatur zu bestimmen ist, bekannt (Figur 1 i. V. m. Sp. 2, Z. 40-47; Merkmal **1.0**), das in Übereinstimmung mit dem Anspruchsgegenstand folgende Verfahrensschritte aufweist:



- zwischen dem Temperatursensor (1) und dem Element (3) wird ein wärmeleitendes Medium, nämlich eine - auch als Vergussmasse wirkende -, „pastöse Wärmeübertragungsmasse 7“ (**D2**, Sp. 2, Z. 58-65) angeordnet (Merkmal **1.1**),
- in dem Element (3) wird eine Ausnehmung („Einbeulung 4“) ausgebildet (**D2**, Figur 1 i. V. m. Sp. 2, Z. 51-55; Merkmal **1.2<sub>teils</sub>**),
- der Temperatursensor (1) wird in die Ausnehmung (4) zur thermischen Kopplung hineingedrückt (**D2**, Figur 1 i. V. m. Sp. 2, Z. 58, bis Sp. 3, Z. 4; Merkmal **1.3<sub>teils</sub>**);
- das wärmeleitende Medium (7) ist als festes, elastisches Wärmeleitelement mit überwiegender flächiger Ausdehnung ausgebildet (**D2**, Figur 1, BZ 4); die pastöse Masse stellt sich für den Fachmann nach Aushärtung als nicht komplett unelastisch dar, da in diesem technischen Umfeld die funktionsnotwendige, für eine Temperaturmessung baulich randbedingungserhaltende Abstimmung der thermischen Ausdehnungskoeffizienten des Elements und der pastösen Masse aufeinander erforderlich ist (**D2**, Figur 1 i. V. m. Sp. 2, Z. 58-65; Merkmal **1.4<sub>teils</sub>**);
- das wärmeleitende Medium (7) kontaktiert die Wandung (4) (**D2**, Figur 1 i. V. m. Sp. 2, Z. 58, bis Sp. 3, Z. 4; Merkmal **1.6<sub>teils</sub>**).

Abweichend zum Anspruchsgegenstand ist bei dem bekannten Verfahren zur Herstellung einer thermischen Kopplung eines Temperatursensors kein Einsatz einer kompressiblen Folie im Sinne der Anmeldung als wärmeleitendes Medium vorgesehen, die zunächst die Ausnehmung überdeckt (Merkmale **1.2<sub>Rest</sub>**, **1.4<sub>Rest</sub>**) und in einem weiteren Schritt zusammen mit dem Temperatursensor zur thermischen Kopplung U-förmig in die Ausnehmung hineingedrückt wird (Merkmal **1.3<sub>Rest</sub>**). Mithin fehlt es auch an einer entsprechenden „mindestens zu zwei Seiten der Wandung“ stattfindenden Kontaktierung der Folie (Merkmal **1.6<sub>Rest</sub>**). Darüber hinaus ist aus der Druckschrift **D2** nicht bekannt, den dort genannten Temperatursensor (1) wie beansprucht auf einer Leiterplatte zu implementieren (Merkmal **1.5**).

Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen weiter ab, so dass das beanspruchte Verfahren auch gegenüber diesen Druckschriften neu ist.

7. Der Gegenstand des einzigen geltenden Anspruchs beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem derzeit im Verfahren befindlichen Stand der Technik (§ 4 PatG).

Der Fachmann mag ausgehend von der Druckschrift **D2** bei Recherchen zur Weiterbildung der dortigen Gegenstände zwar durchaus auf die Druckschrift **D3** (DE 199 13 195 A1) stoßen, die ihn im gleichen technischen Kontext lehrt, einen Temperatursensor auf einer Leiterplatte oder einer leiterplattenähnlichen Struktur vorzusehen und diesen Sensor zum Zwecke von Temperaturmessungen bündig an einem Element anzubringen, dessen Temperatur zu bestimmen ist (**D3**, vgl. Figuren 1 bis 4; Merkmal **1.5**).

Es besteht für den Fachmann jedoch keine Veranlassung, ausgehend vom Verfahren der Druckschrift **D2** und vor dem Hintergrund des derzeit im Verfahren befindlichen Standes der Technik eine kompressible Folie als wärmeleitendes Medium vorzusehen und dieses anschließend wie beansprucht zusammen mit dem Temperatursensor durch das gemeinsame Eindrücken in einer Ausnehmung zu fixieren.

Zwar lehrt die Druckschrift **D6** (DE 26 14 917 A1) dem Fachmann in einem ähnlichen technischen Kontext prinzipiell den Einsatz einer wärmeleitenden Folie im Sinne der Anmeldung (**D6**, „Füllkörper 10“ aus „elastomerem Silicongummi“, S. 5, Abs. 3, i. V. m. Figur 1) und zwar im Rahmen einer Schaltkarte, die aus fachmännischer Sicht auch einen Sensor tragen kann, um „einen einwandfreien Wärmeübergang von den wärmeerzeugenden Schaltelementen auf der Schaltkarte“ zu erzielen (**D6**, S. 2, Abs. 2); dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Einsatz von Vergussmassen in diesem technischen Umfeld als nachteilig erkannt wurde (**D6**, S. 2, Abs. 1, Z. 4-12) und die dort beschriebene Erfindung „überall dort verwendet werden [kann], wo es auf guten Wärmekontakt zwischen den wärmeer-

zeugenden Schaltelementen und der Wärmesenke ankommt“ (D6, S. 4, Abs. 2, Z. 3-6). Jedoch weist diese Druckschrift letztlich in eine andere Richtung, da die Montage und Fixierung der wärmeleitenden Folie (10) dort auf dem bündigen Eingreifen von Schaltelementen in hierfür in ihrer Oberfläche vorgehaltenen Aussparungen bzw. Leerräumen beruht und in keiner Weise ein gemeinsames Verpressen oder Eindrücken von wie auch immer gearteten Bestandteilen der dortigen Schaltkarte mit einer „unversehrten“ Folie in einem weiteren Bauteil gelehrt wird.

Auch die übrigen im Verfahren genannten Druckschriften zeigen kein derartiges Vorgehen.

Jedenfalls beim derzeit vorliegenden Stand der Technik bedarf die anspruchsgemäße technische Realisierung des Verfahrens daher erfinderischer Überlegungen durch den Fachmann.

**8.** Der Senat hat davon abgesehen, in der Sache selbst zu entscheiden und das Patent zu erteilen, da das DPMA das Patentbegehren ersichtlich nur gemäß der damals jeweils herrschenden Antragslage geprüft und weitgehend auch die Recherche darauf begrenzt hat.

Nachdem nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein einer Patenterteilung entgegenstehender Stand der Technik existiert, insbesondere im Hinblick auf die anspruchsgemäße Fixierung des Temperatursensors durch das gemeinsame Hineindrücken mit einer wärmeleitenden Folie in eine Ausnehmung eines zur Temperaturbestimmung vorgesehenen Elements, und eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des relevanten Standes der Technik ergehen kann, wofür die Prüfungsstellen des DPMA zuständig sind, war die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das DPMA zurückzuverweisen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 PatG).

Der Prüfungsstelle obliegt bei der erneuten Prüfung ebenso die Entscheidung darüber, ob die Anmeldung die sonstigen Erfordernisse des § 49 Abs. 1 PatG erfüllt, insbesondere wird sie darauf hinzuwirken haben, dass im Falle einer Patenterteilung die Beschreibung an das geltende Patentbegehren angepasst ist.

### **Rechtsbehelfsbelehrung**

Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, § 101 Absatz 1 des Patentgesetzes).

Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist
- 7.

(§ 100 Absatz 3 des Patentgesetzes).

Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (§ 100 Absatz 1 des Patentgesetzes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (§ 123 GVG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof schriftlich einzulegen (§ 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Postanschrift lautet: Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe.

Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (§ 125a Absatz 2 des Patentgesetzes in Verbindung mit der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130)). In diesem Fall muss die Einreichung durch die Übertragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2 Absatz 2 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht (§ 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Begründung beträgt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbeschwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlängert werden (§ 102 Absatz 3 des Patentgesetzes). Die Begründung muss enthalten:

1. die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird;
2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm;
3. insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestützt wird, dass das Gesetz in Bezug auf das Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben

(§ 102 Absatz 4 des Patentgesetzes).

Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen (§ 102 Absatz 5 des Patentgesetzes).

Musiol

Dorn

Albertshofer

Dr. Wollny

Hu